

柏騰科技 (3518)

法人說明會

日期：2025 / 12 / 02

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提供之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負責更新或修正。

大綱

CONTENTS

- 01 公司簡介
Company Overview
- 02 財務資訊
Financial Information
- 03 進度報告
progress report
- 04 營運展望
Operating status
- 05 資訊交流
Q&A



公司簡介

Company Overview

柏騰科技(3518)

柏騰科技 (台灣證券交易所 | 股票代號3518) 成立 1995年，為全球首家將真空鍍膜(PVD)技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，近年積極轉型開發第三代半導體材料及先進製程技術，為業界少數同時具備生產碳化矽基板、真空鍍膜技術與製程開發的公司。



- ◆ 成立時間：84.10.20
- ◆ 資本額：97,887萬元
- ◆ 董事長：黃逸駿
- ◆ 總經理：游秀屏
- ◆ 目前主要產品及其應用：
 真空鍍膜(PVD) – 佔比99%
 碳化矽 (SiC) – 佔比 1%

關於柏騰



台灣總部&研發中心

- 成立時間：1995年
- 資本額：9億7仟萬
- 台灣桃園市&中國蘇州



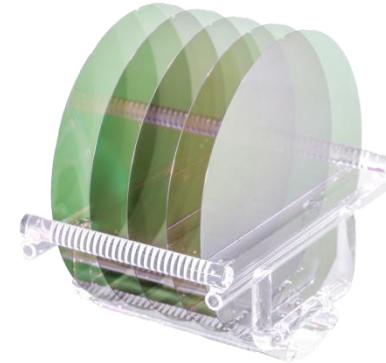
真空鍍膜(PVD)產品

防EMI&外觀鍍膜服務

- 南京廠/內江廠 (PVD鍍膜&設備)

種子層(Seed layer)PVD製程設備

散熱基板薄膜服務



碳化矽(SiC)產品

6~8吋碳化矽(SiC)晶圓

- 導電型(N-Type/P-Type)
- 半絕緣型(HPSI)
- 碳化矽散熱應用
- 晶錠加工&再生晶圓

12吋碳化矽晶圓(開發中)

發展歷程

柏騰為全球首家將真空鍍膜(PVD)技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，目前為NB防EMI最大供應商，2022年併購晶成材料擁有SiC(碳化矽)基板生產技術並進入第三代半導體供應鏈，2025年12月嘉義8吋SiC基板新廠完工，為業界少數同時具備碳化矽基板製造、真空鍍膜技術與製程開發的公司，在未來AI應用中碳化矽已成為未來半導體製程中最重要的材料，柏騰將結合碳化矽材料與真空鍍膜技術的優勢取得領先機會。





財務資訊

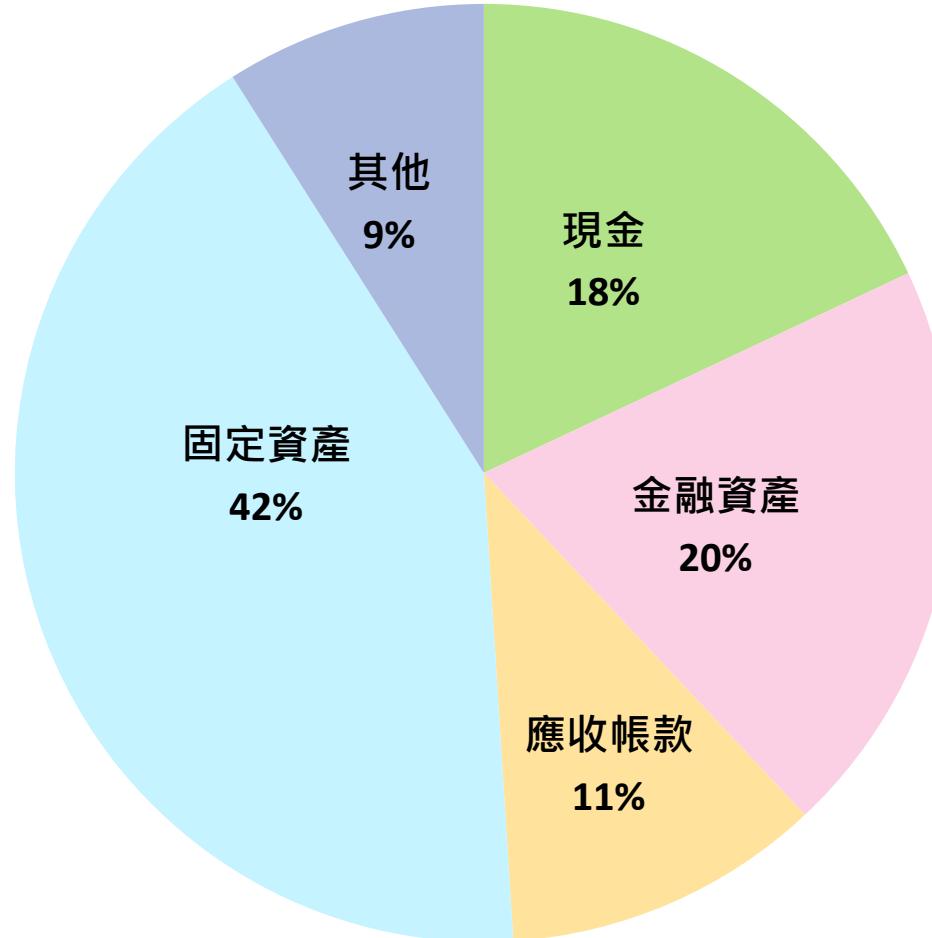
Financial Information

2025年第三季合併資產負債表

單位:新台幣佰萬元

	2025.9.30	%	2024.12.31	%	2024.09.30	%
現金及約當現金	383	18	1,069	49	1,212	54
金融資產-流動&非流動	421	20	228	10	228	10
應收帳款及票據	234	11	246	11	265	12
存貨	13	1	20	1	19	1
待出售非流動資產	10	0	10	0	10	0
固定資產及使用權資產	896	42	413	20	378	17
其他資產	164	8	196	9	145	6
資產總計	2,121	100	2,183	100	2,257	100
短期及一年內到期借款	225	11	171	8	211	10
其他應付款	77	4	114	5	76	3
應付公司債	289	13	284	12	283	13
長期借款	69	3	15	1	31	1
其他負債	137	6	144	7	156	7
負債總計	796	38	729	33	756	34
權益總計	1,325	62	1,455	67	1,501	66
每股淨值	13.57		15.00		15.48	

財務結構與比率



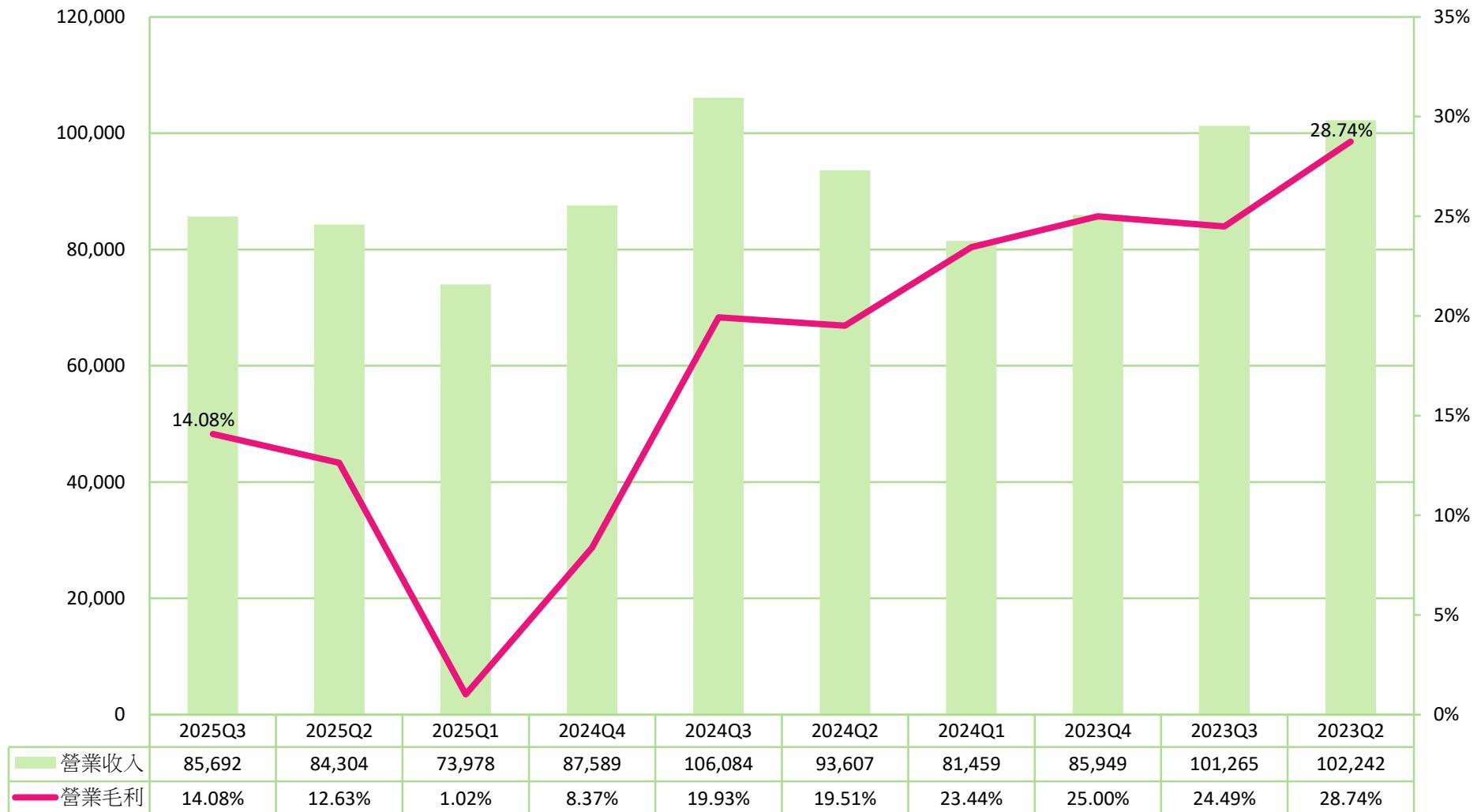
項目	2025年Q3	2024年	2023年	2022年	2021年
負債比率	37.53	33.37	21.49	16.30	24.54
流動比率	332.72	511.45	395.27	606.50	377.86
現金流量比率	(66.04)	(33.46)	(17.17)	63.32	31.54

2025年第三季合併綜合損益表

單位:新台幣佰萬元

項目	2025年第三季	2025年第二季	增減	2024年第三季	增減
營業收入	86	84	2	93	(7)
營業毛利	12	11	1	12	(0)
營業費用	45	49	(4)	69	(24)
營業淨利(損)	(33)	(39)	6	(57)	24
營業外收支	34	42	(8)	(4)	38
繼續營業單位稅前淨利	1	4	(3)	(61)	62
所得稅費用	4	0	4	2	2
繼續營業單位本期淨利(損)	(3)	4	(7)	(63)	59
停業單位淨利(損)	1	1	0	(1)	2
本期淨損	(3)	4	(7)	(64)	62
毛利率 (%)	14%	13%		13%	
純益率 (%)	-3%	5%		-69%	
每股盈餘 (元)	(0.03)	0.04		(0.68)	

收入與毛利率趨勢圖



2025年第三季合併現金流量表

單位:新台幣佰萬元

	2025年1月1日 至9月30日	2024年1月1日 至9月30日
營業活動之淨現金流入(出)	(222)	(96)
投資活動之淨現金流入(出)	(529)	(226)
籌資活動之淨現金流入(出)	95	692
匯率變動對現金及約當現金之影響	(30)	40
本期現金及約當現金增(減)數	(686)	411
期初現金及約當現金餘額	1,069	801
期末現金及約當現金餘額	\$383	\$1,212

重要事件說明

- ◆ 114年第1次私募普通股完成股款繳納暨增資基準日，本次實際私募增資普通股為5,000仟股已收足股款，增資基準日為114年11月20日。(114.11.19)
- ◆ 董事會決議辦理私募普通股定價，訂定20元為本次實際私募價格，本次私募股數5,000,000股，募集金額新台幣100,000,000元。(114.11.05)
- ◆ 董事會通過114年度第三季合併財務報表，114年度累計基本每股損失新台幣0.93元。(114.11.05)
- ◆ 子公司精華國際投資有限公司解除原出售柏靈(蘇州)光電科技有限公司之股權轉讓協議。(114.10.17)
- ◆ 重要子公司柏靈(江蘇)光電科技有限公司公告決議辦理現金減資美金2,500,000元。(114.09.02)
- ◆ 董事會通過114年度第二季合併財務報表，114年度累計基本每股損失新台幣0.90元。(114.08.06)
- ◆ 重要子公司柏騰(內江)光電科技有限公司決議發放股利人民幣8,551,804.26元。(114.06.25)

詳情請參閱柏騰公司網站 (<https://www.pttech.com.tw>) 最新消息公告及公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>) 重大訊息公告。



進度報告

progress report

SiC新廠計劃

- ◆ 建廠預算：新台幣 89,953 萬元(一期)
- ◆ 新廠位置：嘉義大埔美智慧型工業園區
- ◆ 主要產品：8吋SiC晶圓
- ◆ 一期產能：3,000pcs/月 二期產能:6,000pcs/月
- ◆ 2026年加工產能：6,000pcs/月

2024H2
(建置期)

ISO9001及14001認證
通過目標客戶認證
開始建置新廠廠務及工程
導入先進8吋長晶製程設
備，縮短製程開發時間

2025
(新廠啟用)

Q1-Q3廠務工程完工
Q2-Q4設備安裝
Q3-Q4試量產準備
Q4 2026Q1新廠啟動
開發半絕緣產品
- SiC散熱基板
- 12吋SiC基板(開發中)

2026
(一階段)

IATF 16949認證
通過目標客戶認證
年產能24,000pcs
6~8吋SiC基板
6~8吋SiC加工服務
SiC晶圓再生服務
SiC散熱基板

2027
(二階段)

通過車用認證
年產能36,000pcs
進行新廠二期擴產準備
最大年產能72,000pcs

12吋SiC散熱材料
(先進封裝)

新廠進度說明

● 廠務工程進度100%

廠務工程於2025年9月完工，10月開始進行廠務8大系統運行測試及驗收。目前進行竣工及環評申請，預計2026年Q2取得工廠登記證。

● 產能設備建置進度80%

加工設備已全部到廠進行安裝中，預計12月中安裝完畢，2026Q1完成製程調試，2026Q2正式量產。

● 產品驗證進度

8吋產品-多家客戶進行製程驗證中，預計2026年導入量產。

SiC散熱基板-已進行小批量驗證，預計2026年導入量產。

● 業務開發進度

6~8吋SiC基板銷售

6~8吋SiC基板加工服務

6~8吋SiC晶圓再生服務

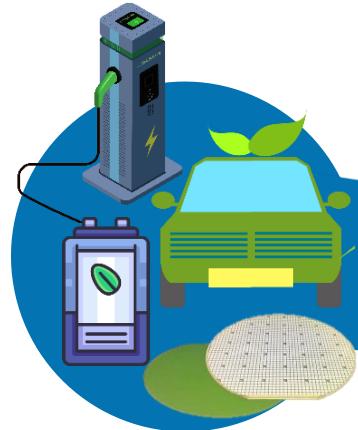
SiC散熱應用 (SiC&PVD)



營運展望

Operating status

產品發展方向

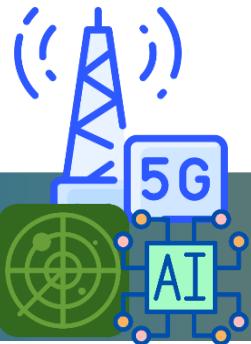


8-inch

- EV
- 高壓電源
- 儲能/綠能系統

P-Type

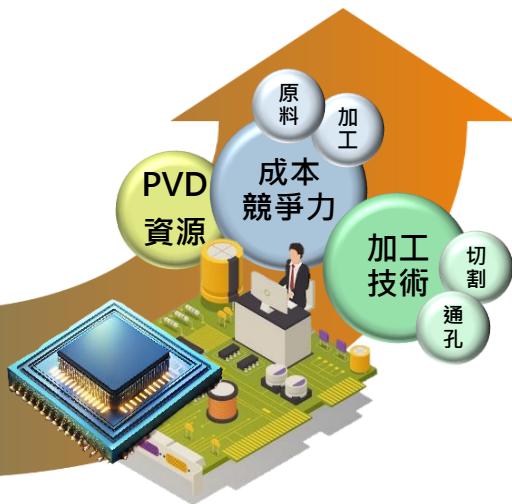
N-Type



12-inch

- 散熱基板
- AI / AR
- 衛星、雷達
- 軍事應用

HPSI



■ 先進封裝

間隙層 spacer

• 增強散熱與封裝結構強度

中介層 interposer

• 增強散熱與多晶片互連

PVD

8吋導電型

6~8吋半絕緣

SiC散熱應用

PVD + SiC

營運展望

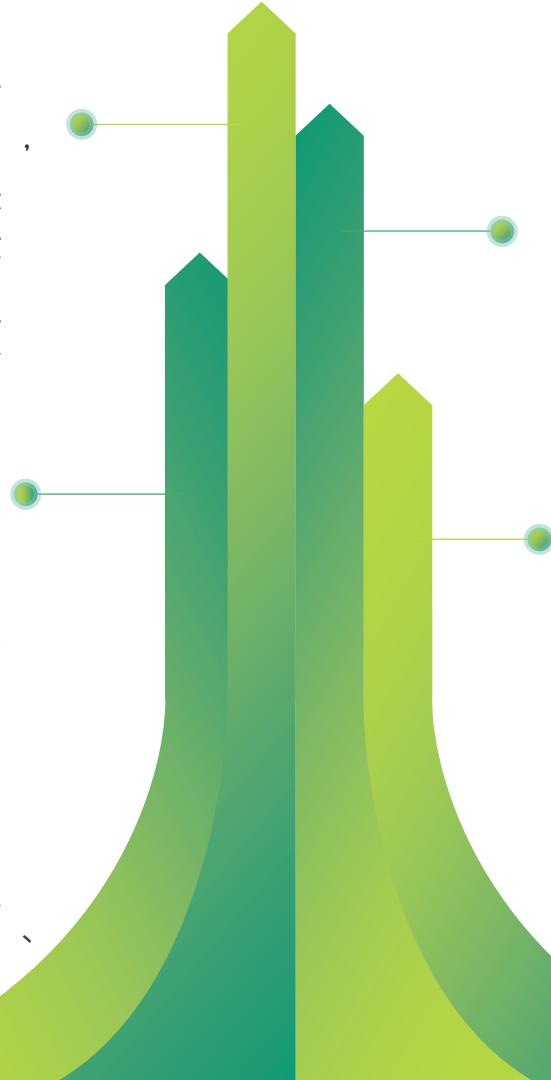
EMI鍍膜產品

整體經濟疲軟與關稅風險升溫，預估2026年筆電品牌全年出貨年增率約3%，因中美關稅成本風險迫使品牌採取更保守的生產與採購策略，短期輸美市場產品產能在今年加速移出中國大陸，使中國EMI訂單受到影響，2026年仍需持續觀察對於中國市場營運的影響程度。

PVD鍍膜技術

真空濺鍍(PVD)鍍膜技術應用範圍相當廣泛，尤其為符合ESG及環保減碳的趨勢潮流下，將PVD鍍膜技術應用在功能鍍膜及外觀表面處理。

- (1)AF鍍膜 - NB產品
- (2)類陽極鍍膜 - NB、3C產品
- (3)功能鍍膜 - 散熱膜、先進封裝重佈線路(RDL)、金屬種子層(Seed layer)、晶背金屬化等。



SiC晶圓產品

全球8吋晶圓廠將陸續開始量產，研調機構預估2028年6:8吋晶圓需求佔比將達到1:1，8吋SiC晶圓年均成長率(CAGR)可望達到18.5%。

單晶SiC基板在高導熱材料中具有良好的導熱能力，目前半導體大廠積極開發SiC散熱材料的應用，未來將進一步擴大整體SiC材料需求。

SiC加工服務

- (1)6~8吋晶錠加工
- (2)SiC再生晶圓(Reclaim)
- (3)SiC散熱基板及減薄服務

新廠具備晶體加工產能，加工月產能可達7200片，就近提供國內6吋及8吋長晶廠晶圓加工及磊晶廠SiC再生晶圓(Reclaim)服務。



資訊交流

Q&A

TRUE PARTNER FOR A BRIGHTER FUTURE

發言人：劉明怡 財務處副總

電 話：(03)212-8833

E-mail : mingi@pttech.com.tw.

